

デジタルファクトリー通信

2023年6月～2023年7月



東京エレクトロン デバイス株式会社

ハイライト

7月 トピックス

1	【特集記事 1】これからのロボット導入に必要な勘所とは？ 【第1話】ロボット導入が進まない要因と対策
2	【特集記事 2】 脱！データ活用迷子「データ活用の始め方を知る」 製造業の課題解決に向けたモノづくりDX 計画作成講座
3	【特集記事 3】 注目！AI時代の発展を支える半導体製造技術 【第8話】「シリコンブリッジ」とは

6月 トピックス

1	【特集記事 1】 製造現場のデータを一瞬でグラフ化！ 無料で簡単「CSVファイル可視化ツール」とは
2	【作業の自動化】 成長型ビジョンオートメーションシステム TriMath
3	【特集記事 2】 注目！AI時代の発展を支える半導体製造技術 【第7話】「部品内蔵基板」とは

【特集記事 1】

7-1

これからのロボット導入に必要な勘所とは 【第1話】ロボット導入が進まない要因と対策



※画像をクリックすると直接サイトに移動します

人手不足が進む日本社会において、人手作業の自動化は急務となっています。ロボット導入を検討してるが、なかなかうまく進まず悩んでいる方は多いです。ここではロボット導入を上手く進められる取り組み方を紹介します。

◆目次◆

1. ロボット導入を阻む2つの要因
2. 解決のポイントは「技術」ではなく「取り組み方」
3. 事例から考える導入効果のシナリオ

作業組み合わせが少ない工程をロボット化



▼詳細はこちら

<https://www.inrevium.com/pickup/robot-introduction/>

【特集記事 2】

7-2

脱！データ活用迷子「データ活用の始め方を知る」 製造業の課題解決に向けたモノづくりDX 計画作成講座



クリック！

製造業でデータ活用を考えているお客様の声を聴いている中で現場の悩みはデータ取得の前段階にある事がわかりました。

「どのようにデータを収集すればよいか」
「どのように進めていけばよいか」

このお悩みを解決すべく『お客様がゼロから計画を立てる』に焦点を当てます。



CN BU
アプリケーションサービス開発部
サービス開発グループ
グループリーダー
岡田大輝
データサイエンティスト。設計、アルゴリズム開発などを担当



CN BU
アプリケーションサービス開発部
アカウントマネジメントグループ
グループリーダー
高山桂一
課題解決の提案など顧客対応とプロジェクトの進捗管理などを担当

お話を聞いたのは
この方！



▼詳細はこちら

<https://www.inrevium.com/pickup/dx-course/>

【特集記事 3】

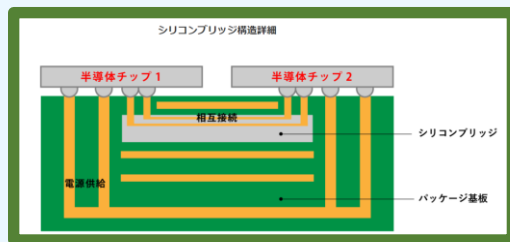
注目！AI時代の発展を支える半導体製造技術 【第8話】「シリコンブリッジ」とは

7-3



※画像をクリックすると直接サイトに移動します

シリコンブリッジ技術とは、半導体パッケージ内部に相互接続用のシリコン基板を埋め込み半導体パッケージ上部に搭載されるシリコンチップを高密度に実装、相互接続する技術です。



◆目次◆

- [1] シリコンブリッジ技術とは
- [2] シリコンブリッジ技術とシリコンインターポザー技術の比較
- [3] シリコンブリッジ技術の課題と展望

▼詳細はこちら

<https://www.inrevium.com/pickup/asilicon-bridge/>

6-1

【特集記事 1】 製造現場のデータを一瞬でグラフ化！ 無料で簡単「CSVファイル可視化ツール」とは

無料ダウンロードですぐに使える
CSV グラフ化フリーソフト
ダウンロードはこちら

※図をクリックすると直接サイトに移動します

取得したデータを手間なくグラフで確認しませんか？
データを一瞬で可視化して問題を把握。傾向やパターンが一目に見え、正しい判断が可能です。優れた機能やツールの使いどころをまとめました。



予知保全・品質改善での使いどころ3選

1. 収集データの簡易チェック（現状把握）
2. データの特徴を視覚的に把握（パターンの確認）
3. 分析のためのデータ前処理（AIモデル作成用のトレーニングデータ準備）

◆詳細はこちら

<https://www.inrevium.com/pickup/visualization-tool/>

【作業の自動化】

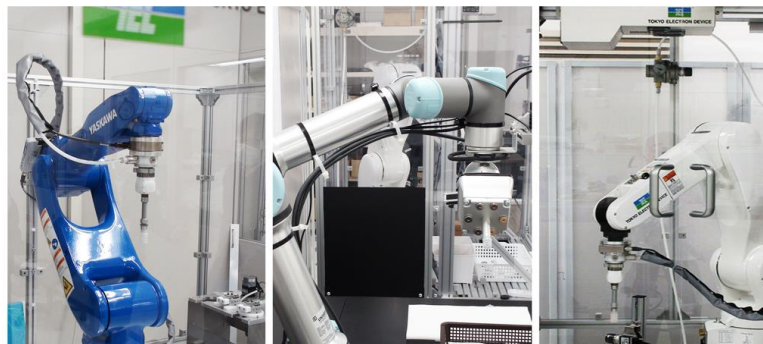
成長型ビジョンオートメーションシステム TriMath

6-2

成長型（現場で生まれ続ける要望に現場で応えられる）
ビジョンオートメーションシステム（現システム全体を制御、導入プロセスを簡易化）

専門
知識
不要

※図をクリックすると直接サイトに移動します



こんな お困り事 はありませんか？

【お困り事】

1. ビジョンの選定 ➡
2. システム構築 ➡
3. エンジニア不足 ➡
4. 現場で生まれ続ける要望 ➡

【成長型ビジョンオートメーションシステム】

- 選定不要！
- システムをパッケージ化
- 設計・製作削減
- 素早い動作改善！

ビジョンロボットの各パーツをシームレスに連携。システム導入プロセスを大幅に簡素化。

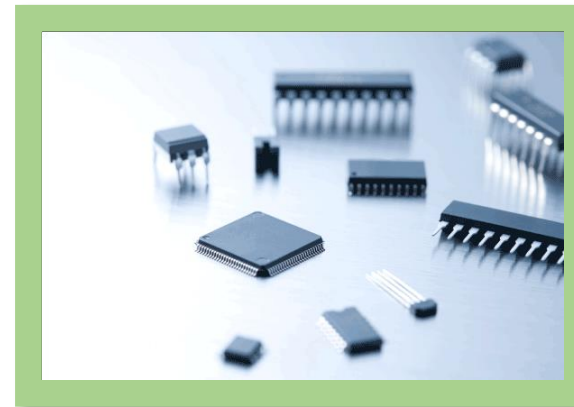
◆詳細はこちら

<https://www.inrevium.com/product/trimath/#detail-1>

【特集記事 2】

注目！AI時代の発展を支える半導体製造技術 【第7話】「部品内蔵基板」とは

6-3



※画像をクリックすると直接サイトに移動します

先端半導体の技術の中でも微細化と並んで今後の半導体性能を大きく左右する、3次元実装技術。その構成技術である**部品内蔵基板**について解説します。

◆目次◆

- [1] 部品内蔵基板とは
- [2] 部品内蔵基板の使用アプリケーション
- [3] 部品内蔵基板の今後と課題

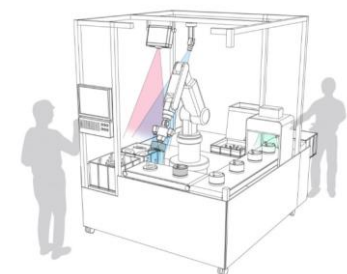


▼詳細はこちら

<https://www.inrevium.com/pickup/embedded-pcb>

TED デジタルファクトリーソリューション

成長型ビジョンオートメーションシステム
TriMath



ロボット
システム

ウェーハ
検査装置

ウェーハ外観検査装置
RAYSENS



パーツカウンター
めばかり君



入荷

原材料

加工

組立

検査

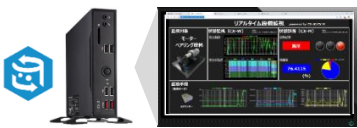
出荷

設備監視
データ分析

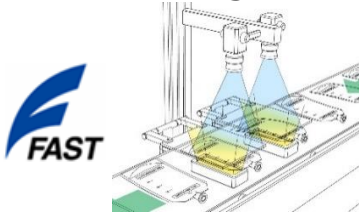
時系列データ自動分析マシン
CX-M



異常検知・設備診断システム
CX-D



計測・検査ソリューション
FAST



セキュリティ
IPS
マルウェア/脆弱性対策



TED デジタルファクトリーソリューション 詳細一覧

詳しくはWEBで！ <https://www.inrevium.com/>

➤ 予知保全

製品

- [異常検知・設備診断システム](#)
- [時系列データ自動分析マシン](#)
- [異常検知 組込AIソフトウェア](#)
- [CSVファイル 可視化・加工ツール（無料）](#)

サービス

- [モノづくりDX 計画作成講座](#)

ソリューション

- [AEセンサによる設備異常の予兆監視](#)

➤ 計測・検査

製品

- [半導体ウェーハ外観検査装置](#)
- [計数器・パーツカウンター](#)
- [画像処理ライブラリ](#)
- [汎用画像処理装置](#)
- [位置決め装置](#)
- [温湿度モニタリングシステム](#)

ソリューション

- [金属プレス部品 外観検査](#)
- [薬液バッグ製造 外観検査](#)
- [カーボン繊維積層 異物検査](#)
- [3次元塗布検査](#)
- [不定形物への塗布経路補正](#)
- [ピッキングロボットの位置補正](#)

➤ ロボット

製品

- [成長型ビジョンオートメーションシステム TriMath](#)
- [材料袋のデパレタイズロボット](#)
- [鋳物部品のピッキングロボット](#)
- [商品のピースピッキングロボット](#)
- [メッキ部品のハンドリングロボット](#)

ソリューション

- [洗濯機ピッキング・デパレタイズ](#)
- [室外機 ピッキング・仕分け](#)
- [鉱石 ピッキング・仕分け](#)
- [袋 ピッキング・デパレタイズ](#)
- [電子機器ハーネス組立](#)
- [組立作業ロボットの位置補正](#)